

3rd Edition

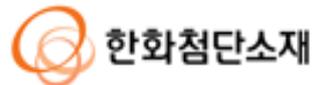
고기능 점·접착 기술 세미나

일시 2016년 5월 27일(금)

장소 여의도 전경련 회관 컨퍼런스센터

주최 화학경제연구원 컨설팅사업부

발표기업



프로그램

Time	Contents	Speaker
[Module 1]	Opportunities for Adhesives in Automotive Market	
10:00 - 10:40	자동차 경량화 트렌드에 따른 이종재질 접합 및 복합재료용 접착/본딩기술 동향 - 자동차 경량화에 따른 복합소재 적용 시 결합 체결 방법 소개 - Steel-플라스틱 등 이종소재간 결합 기술 소개 - 복합소재의 강성 보강 결합 방법 소개	덕양산업 곽성복 부장
10:50 - 11:30	자동차 NVH (Harnessing Noise Vibration) 용 점착테이프 수요 및 적용기술 High performance, lightweight pressure-sensitive adhesives (PSAs) overcome automotive brake and engine compartment challenges * 본 강의는 별도의 통역 없이 영어로 진행됩니다.	Avery Dennison Performance Tapes Michel Ravers Applications Technical Service Engineer
11:40 - 12:20	접착제를 응용한 미래형 자동차 전기/전장 부품 솔루션 - 자동차 산업의 전기/전자화 동향 - 전기/전장 부품에 적용/응용될 수 있는 접착제 기술	헨켈코리아 이동하 부장
12:30	점심식사	
[Module 2]	Raw materials and its Development for Adhesives	
13:30 - 14:10	석유수지 개요 및 점·접착 응용 기술 - 석유수지의 종류 및 특징 - 석유수지 기반 핫멜트 접착제 응용기술 (Hot Melt Adhesive, Hot Melt Pressure Adhesive, Hot Melt Road Marking 등)	코오롱인더스트리 박준효 그룹장
14:20 - 15:00	폴리프로필렌 수지 기반 접착특성 부여 및 접착 활용 기술 - 폴리프로필렌수지 특성 및 분야별 기술 이슈 - 점·접착성 폴리프로필렌계 수지 및 특징 - 활용 분야 및 최근 이슈	롯데케미칼 김선미 수석연구원
[Module 3]	Opportunities for Adhesives in Electronics Market	
15:10 - 15:50	FPCB구성 접착/필름 소재 및 기술동향 - FPCB 소개 및 시장동향 - FPCB 구성 접착/필름 제품동향 - 관련 이슈 및 향후 연구방향 (저유전/방열/무선충전/전자파차폐/전장용)	한화첨단소재 이병후 책임연구원
16:00 - 16:40	모바일용 테이프/본딩 솔루션 및 기술 동향 - 모바일용 전자시장 동향 - 모바일용 테이프/본딩 솔루션 및 기술 동향	3M 박해동 수석연구원

* 프로그램의 주제 및 일정은 연사의 사정에 의해 일부 변경될 수 있습니다.

강의소개



자동차 경량화 트렌드에 따른 이종재질 접합 및 복합재료용 접착/본딩기술 동향 덕양산업 선행연구팀 곽성복 부장

본 시간에는 전기자동차 등 자동차 경량화 실현을 위한 기술 개발 시 요구되는 이종 및 복합 소재의 소재/부품간 결합을 위한 다양한 방법에 대해 알아보고 접합 방법에 따른 최적의 방법에 대하여 연구한 결과를 소개하고자 한다. 또한 자동차 복합소재 경량화 기술 개발 시 필연적으로 검토해야 하는 결합 방법에 대한 실증에서의 경험을 소개하고자 한다.



자동차 NVH (Harnessing Noise Vibration) 용 점착테이프 수요 및 적용기술 Avery Dennison Performance Tapes, Applications Technical Service Engineer, Michel Ravers

- 1) Discussion of industry demands for harnessing noise vibration in vehicles.
 - a. Overview of how constraint layer damping with PSA tapes helps to harness noise vibration.
 - b. Description of Avery Dennison Performance Tapes experience and expertise with PSA in automotive applications.
- 2) How to fine tune PSA tapes for optimal damping behavior while maintaining adhesive functionality.
- 3) How to optimize damping at different temperatures and peak or broad damping behavior at several frequency areas.
- 4) Constraint layer damping.
 - a. Measurement procedures.
 - b. Testing procedures: vibrating beam testing.
- 5) Case study: Avery Dennison Performance Tapes developed the damping layer for a motor compartment part application (oil pan).
- 6) Case study: PSA tapes in brake application



접착제를 응용한 미래형 자동차 전기/전장 부품 솔루션(가스켓/실링 중심으로) 헨켈코리아 기술연구소 이동하 부장

미래형 자동차 개발의 주요 경향은 친환경과 운전자 편의성이라 할 수 있으며, 이로 인하여 자동차에서 전기/전자 부품의 비중은 나날이 증가하는 추세이다. 이에 본 강의에서는 자동차 부품의 솔루션으로서 응용/적용될 수 있는 기능성 접착제(가스켓/Potting/Sealing/함침기술 등)를 전반적으로 조망한다.



석유수지 개요 및 점-접착 응용기술 코오롱인더스트리 중앙기술원 박준효 그룹장

본 강의에서는 석유수지의 종류와 특징에 대해 알아보고 석유수지의 대표적 응용분야인 HMA, HMPSA, HMRM 등의 응용기술과 현황에 대해 소개한다.



폴리프로필렌 수지 기반 접착 특성부여 및 접착 활용 기술 롯데케미칼 김선미 수석연구원/그룹장

본 강의에서는 비극성 소재인 폴리프로필렌의 표면코팅 및 등-이종 소재와의 접착방법을 소개하고 특히 폴리프로필렌계 수지의 기능화를 통한 접착성 수지 제조기술 및 활용분야와 최근 이슈에 대해 소개하고자 한다.

**FPCB 구성 접착/필름 소재 및 기술 동향****한화첨단소재 이병후 책임연구원**

전자제품의 소형화 및 경량화가 가속화 되면서 절연성과 내열성이 뛰어나고 3 차원 배선이 가능하도록 유연성과 굴곡성을 부여한 FPCB(Flexible Printed Circuit Board)에 대한 관심이 높아지고 있습니다. FPCB 를 구성하는 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate), Coverlay, Bonding Sheet 등 소재에 대한 시장동향 및 전반적인 이해 그리고 FPCB 업체의 개발 이슈인 저유전 소재, 방열소재, 전자파차폐 소재, 전장용 소재 등에 대한 개발 동향 등을 소개하고자 한다.

**모바일용 테이프/본딩 시장 및 기술 솔루션****한국쓰리엠 기술총괄본부 박해동 수석연구원**

본 강의에서는 모바일 전자시장에 대한 최신 트렌드와 이에 따른 모바일용 테이프 적용시장 현황에 대해 살펴보고 3M 에서 진행하고 있는 모바일용 테이프/본딩 솔루션 및 기술에 대해 소개한다. 또한 모바일용 테이프의 향후 기술 방향에 대해 논의하고자 한다.

등록안내

참가비

구분	신청시기	금액	그룹 할인
Early Bird	04/04 - 04/29 (18시 마감)	30만원(VAT별도)	· 3인 이상 신청 시 전체금액의 10% 할인 * 홈페이지에서 일괄신청 시 할인적용 가능 (개별 신청시 할인 적용 불가)
일반	04/30 - 05/25 (18시 마감)	35만원(VAT별도)	
현장등록	05/26 - 05/27 * 선착순 마감될 시 현장등록 불가	40만원(VAT별도)	

신청방법

· 인터넷 신청 (<http://www.cmri.co.kr/>) → 무료회원가입 → 로그인 → 원하는 프로그램 클릭 → 신청하기 → 온라인결제 → 접수완료

취소 및 환불 규정

· 세미나/교육 10일 전까지(신청일 ~ 5/17 18:00) 100% 전액 환불 가능하며, 9일 전부터는 환불되지 않습니다.

문의

- 세미나 관련 문의 : 세미나팀 (02-6124-6660~8 ext. 503 seminar@chemlocus.com)
- 세금계산서 관련 문의 : 총무팀 (02-6124-6660~8 ext. 204 chemj@chemlocus.com)

기타

- 프로그램의 주제 및 일정은 연사의 사정에 의해 일부 변경될 수 있습니다.
- 한정된 좌석으로 인하여 조기 접수 마감될 수 있습니다.
- **홈페이지 사전등록 시 현장결제를 선택할 경우 현장등록 참가비가 적용됩니다.**
- 세미나 참가 신청일로부터 5일(영업일 기준)내에 참가비가 결제되지 않을 경우 신청이 취소될 수 있습니다.
- 주차는 무료이나 당일 교통혼잡이 예상되오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다
- 점심식사는 등록 시 식권을 수령하시어 사용하시기 바랍니다.

장소안내

서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 3층 다이아몬드홀

[전경련회관 교통 안내 >](#)

